



## BGA-REPAIR

REPARATUR UND TEST IHRES PRODUKTES

 **S.E.P. PROTRONIC**

### WIR BIETEN DIE PASSENDE LÖSUNG

- Fine Pitch bis hinab zu 0.4 mm Rastermaß
- BGA bis 0.5 mm Rastermaß
- CSP bis 0.5 mm Rastermaß
- Chip-Bauteile bis hinab zu 0402/1005 M
- Bedrahtete Bauteile

### IHRE VORTEILE DURCH UNSERE ZUSAMMENARBEIT

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung bei der Reparatur von elektronischen Baugruppen sind wir spezialisiert auf den Tausch von werthaltigen Bauelementen. Mit unseren umfangreichen Rework-Möglichkeiten bieten wir Ihnen ein umfassendes Servicekonzept zu äußerst attraktiven Preisen.

### WAS WIR IHNEN BIETEN

- Reparatur des Produkts nach Qualitätsstandard IPC-A-610 E
- Reparatur umfasst sowohl das Entfernen der defekten Komponente als auch das Bestücken des neuen Bauteils
- Überprüfung des Reparaturergebnisses bei BGA/CSP mittels XRAY und auf Wunsch Dokumentation durch mitgelieferte Röntgenaufnahmen
- Erstellen eines optimalen Temperaturprofils einschl. Archivierung zur späteren Wiederverwendung
- Der Lötprozess erfolgt standardmäßig bleifrei, kann aber auf Kundenwunsch auch bleihaltig durchgeführt werden
- Trocknung der Bauteile/Leiterplatte vor der Reparatur je nach Anforderung
- Reballing

### ATTRAKTIVE SERVICE-ANGEBOTE

Je nach Anforderung und Dringlichkeit können wir ein für Sie angepasstes Servicepaket bieten:

Standard/Express: 24h / 2 Tage / 5 Tage

- Reparatur der defekten Leiterplatte/Komponente
- Röntgen XRAY zur Qualitätssicherung- und Nachweis
- Reballing

Die Serviceangebote setzen voraus, dass die benötigten Werkzeuge und Materialien verfügbar sind oder bereitgestellt werden. Die Berechnung erfolgt nach Aufwand.

